

水平実装で、高放熱特性を約束

Promise excellent heat dissipation characteristics in horizontal packaging

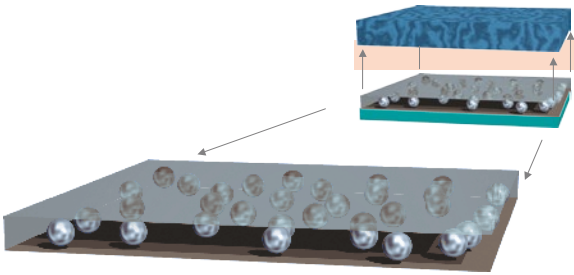
特長

- 傾斜起因のクラックを抑制、高放熱特性を実現
- 一定のはんだ厚確保とボイド低減で、高放熱特性を実現
- 傾斜無きベアチップで、信頼性の高いW/Bを実現

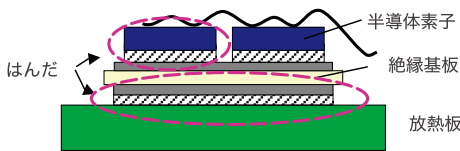


仕様

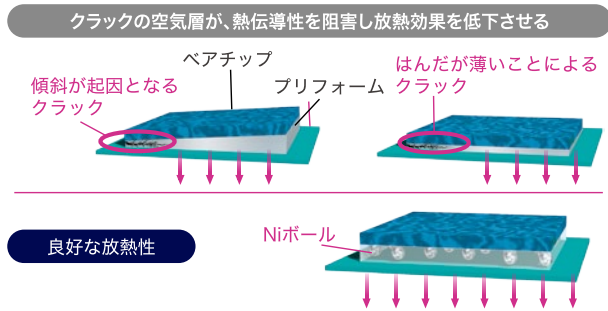
● Niボール含有で、水平実装が可能



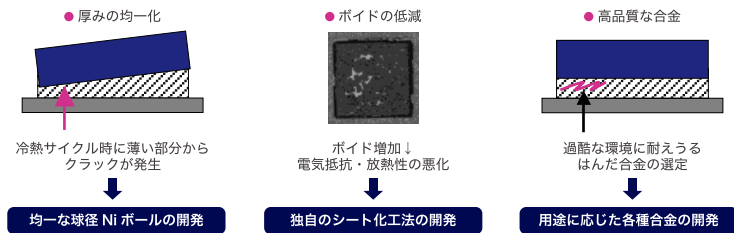
● パワーデバイス実装の課題解決



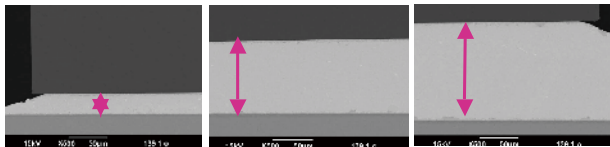
● 高い放熱効果



パワーデバイス実装の課題解決

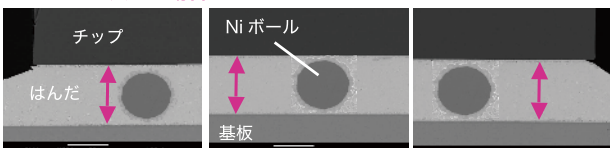


● Ni ボール無しの場合



チップが傾いており、はんだ厚みが不均一

● Ni ボール入りの場合



Ni ボールが部品のスタンドオフを確保する

● 独自工法によるシート化で表面酸化を抑制し、良好なはんだ濡れ性を維持

